

ひとわざ(一技)名: 半導体製造装置を使用した高精度研削・切削加工

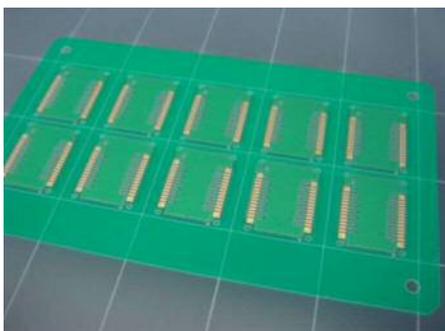
1. 概要(200字目安)

半導体製造装置を使用した、研削、切削加工受託。
研削厚み精度 $\pm 3\mu\text{m}$ 切削位置精度 $\pm 3\mu\text{m}$

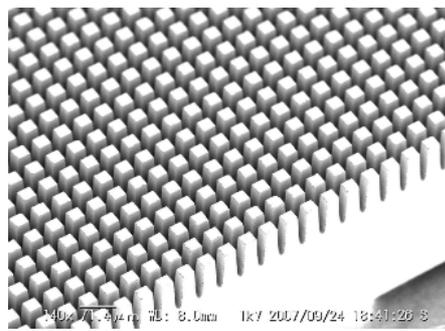
1. 半導体製造装置を使用し、シリコンウエハはもちろん、様々な素材の高精度研削、切削加工を承ります。
2. 加工方法の汎用性が高いため、低コスト、短納期が実現できます。
3. 加工後の製品も、トレイへの収納、外観検査、真空梱包など、柔軟に対応致します。

写真・図(要点説明)

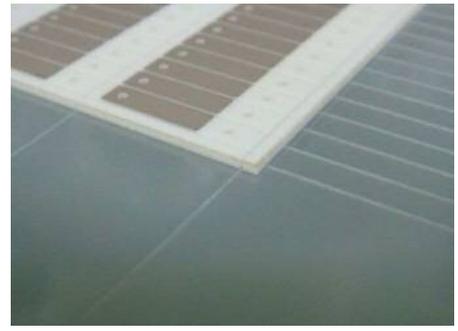
加工例



ガラエポ基板切削



シリコン基板の溝入れ加工
(30 μm 幅)



アルミナセラミックス切削

2. 企業概況

会社名	株式会社 ニチワ工業	代表者名	寺澤 茂
		窓口担当	佐藤 努
事業内容	半導体加工・検査 洗浄	URL	http://www.nichiwak.co.jp
主要製品	精密研削・切削加工、情報画像サプライ品の製造、工場野菜の製造販売		
住所	〒391-0003 長野県 茅野市 本町東 3-17		
電話/FAX	0266-72-6840/0266-72-2498	E-mail	info2@nichiwak.co.jp
資本金(百万円)	15	設立年月日	1970.3.1
		売上(百万円)	1200
		従業員数	120

特記事項(①特許取得・各種認証等取得状況②提供できる価値及び応用分野③医療分野参入(取引)実績 他

- ① ISO9001/ISO14001 認証取得
- ② 半導体加工装置を使用するため、高精度かつ大量生産が可能。